

研究会のご希望： オープン型 クローズ型（どちらかに○を付けてください）

【研究テーマ】

金属ペースト印刷による配線形成と実装向けめっき析出技術について

技術のステージ 基盤研究・応用研究 実用化研究

【研究内容】

研究目的： あらゆる基材に金属ペーストを印刷し実装可能な回路配線形成を行う。

特徴： 印刷で回路形成するので、従来の技術に比べ不要な部分の銅箔を除去によるロス無くすることが出来る。

知的財産の有無など 無し

【狙いの分野、用途】

これまでの電子回路は、サブトラクティブ法と呼ばれる、全面に金属を貼った上で不要な部分を溶かす、という手法で作られてきました。この工法では銅箔製造、フィルムラミネート、露光、現像、エッチング等非常に工程が長く、また不要な部分の銅箔を溶解・廃棄する必要があり、環境負荷が高くなりがちです。

その工程を金属ペーストをスクリーン印刷することにより解決できます。

またこの印刷された金属ペーストに弊社の技術で実装可能なめっきを施すことにより、取り扱いが容易となります。

【従来技術に対する優位性】

回路形成工程の短縮。

銅箔の溶解・廃棄がなくなり環境負荷を減らすことが出来る。

【波及が期待される分野、用途】

既存基板作成への展開。

ウェアラブル端末等